

株式会社東京精密 2020年度(2021年3月期) 決算説明会

2021年5月10日

決算説明会 当社出席者：
代表取締役社長CEO 吉田 均
代表取締役副社長COO 木村 龍一
代表取締役CFO 川村 浩一

◆ 将来の事象に係わる記述に関する注意

- ▶ 本資料に記載されている情報、ならびに口頭で提供される情報は、現時点で入手可能な情報をもとに、当社が合理的であると判断した一定の前提に基づいております。
- ▶ これらは、市況、競争状況、半導体業界ならびに自動車関連業界等の世界的な状況を含む多くの不確実な要因の影響を受けます。
- ▶ 従って、今後の当社の実際の業績が、本資料に記載されている情報と大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

◆ 表記データ・用語について

- ▶ 注記がある場合を除き、半導体製造装置セグメントを「半導体」、精密計測機器セグメントを「計測」、また親会社株主に帰属する当期純利益を「当期純利益」と記載します。
- ▶ 記載されている金額や比率の情報は、注記がある場合を除き、億円またはパーセントによる要約表示を行っております。その為、内訳の計が、合計と一致しない場合があります。

◆ 監査について

- ▶ 本プレゼンテーション資料は、監査法人による監査の対象外です。

次第

- ◆ 2020年度 業績説明
- ◆ 中期目標 2020年度総括, 最終年度にあたって
- ◆ 2021年度 業績予想
- ◆ 質疑応答

2020年度 連結業績



通期業績(億円)	2019年度				2020年度				
	通期				通期	予想対比	前期比		
受注高	876				1,171		+34%		
売上高	879				971	+51	+10%		
営業利益 (営業利益率)	123 (14%)				156 (16%)	+24	+27%		
経常利益	124				159	+26	+28%		
当期純利益	72				122	+22	+70%		
1株配当	76円				104円	+20円	+28円		

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	187	196	225	268	187	210	351	423	+21%	+58%
売上高	180	240	222	237	211	240	216	304	+41%	+28%
営業利益 (営業利益率)	18 (10%)	38 (16%)	34 (15%)	33 (14%)	32 (15%)	31 (13%)	30 (14%)	62 (20%)	+106%	+88%
経常利益	19	38	34	32	33	31	29	65	+121%	+104%
当期純利益	14	29	23	6	25	22	23	52	+132%	+755%

▶ 前年同期比 増収増益 半導体製造装置の売上増寄与

May 10th, 2021

Copyright 2021 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

4

- 2020年度は 新型コロナウイルス拡大の影響を計測事業で受けるも、半導体製造装置事業の業績は伸長、最終的には増収増益で着地
- 期末配当は62円を予定 (5月10日 適時開示をご覧ください)

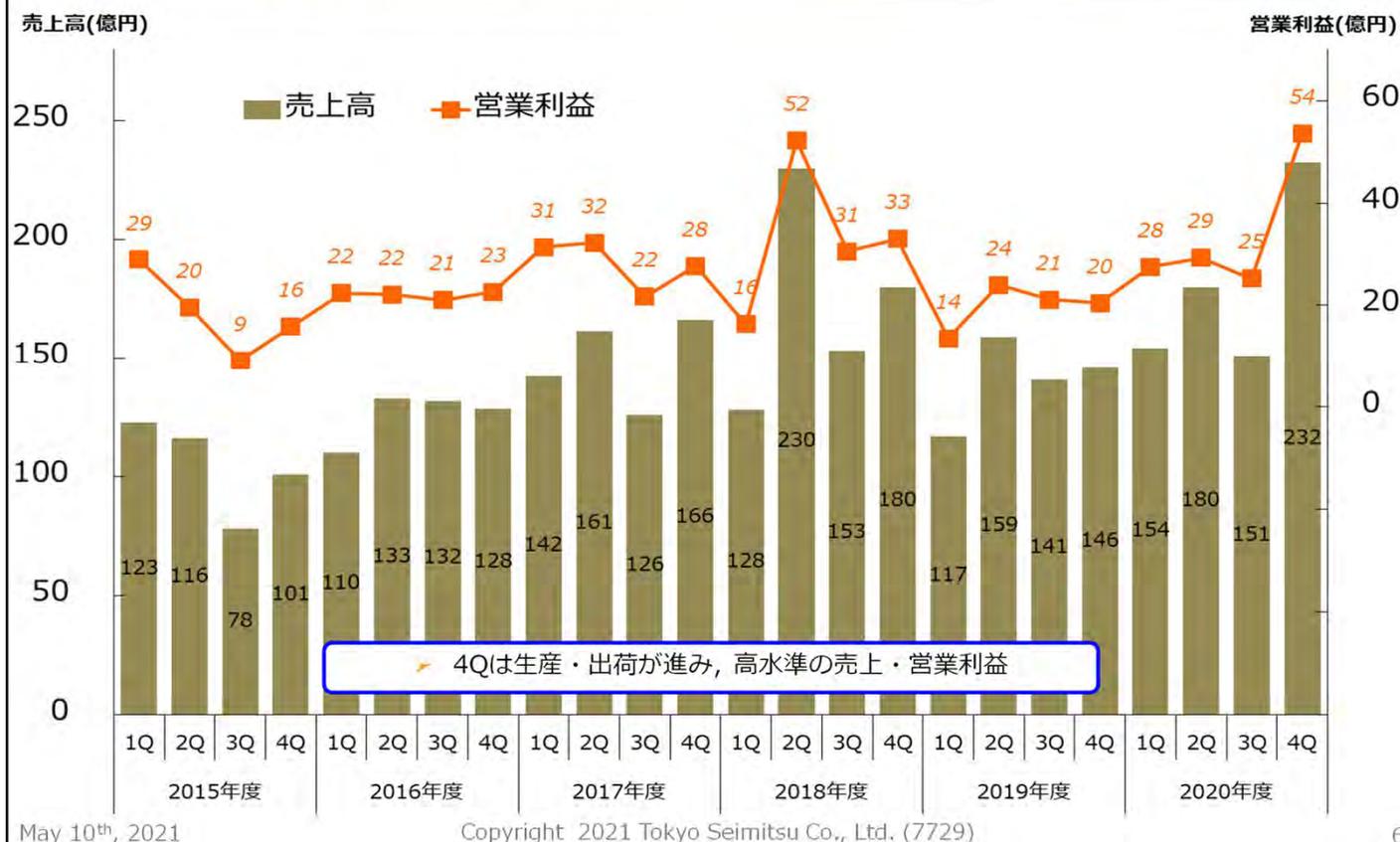
セグメント業績 (通期：億円)	2019年度		2020年度	
	通期		通期	予想対比 前年同期比
受注高	577		932	+62%
売上高	562		717	+33% +28%
営業利益 (営業利益率)	79 (14%)		136 (19%)	+71%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	107	122	154	195	129	159	287	357	+24%	+83%
売上高	117	159	141	146	154	180	151	232	+54%	+59%
営業利益 (営業利益率)	14 (12%)	24 (15%)	21 (15%)	20 (14%)	28 (18%)	29 (16%)	25 (17%)	54 (23%)	+112%	+162%

- 売上高は公表予想対比上振れ
- 増収を背景に営業利益, 利益率ともに上昇
- 受注高は既往ピークを更新

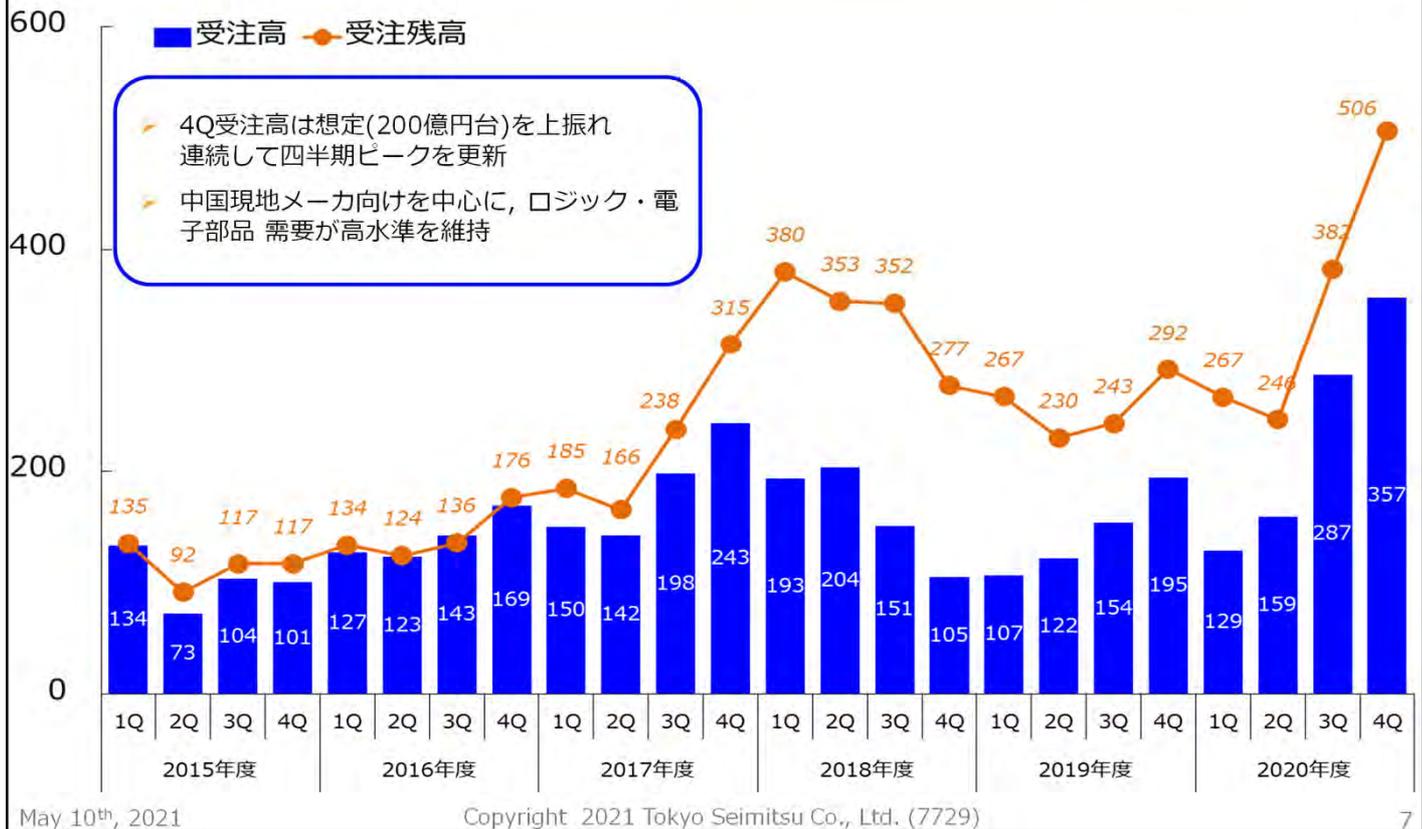
- 売上高は公表を上振れ, 増収が営業利益率の改善にも寄与
- 通期受注高は既往ピークを更新
- 4Qは, 売上増加により 営業利益率も23%へ上昇

半導体 - 売上高, 営業利益



○ 4Qは生産・出荷が進み, 売上高は四半期ピーク, 営業利益も増加

半導体 - 受注高, 受注残高



- 4Q受注は想定(200億円台)を大幅に上振れ, 四半期ピークを連続で更新
- 中国の需要が全体の半分近くを占めたほか, ロジック系, 電子部品系などに, 強い引き合いが見られた



- 2020年度の製品別比率：
 - 売上高(左側): 検査装置(プローバ) 6割前半, 加工装置(ダイサ・研削装置)3割後半
 - 受注高(右側): 検査装置 5割後半, 加工装置4割前半
- 電子部品向けの研削装置, 中国向けダイサ需要などで, 加工装置の比率を高めた

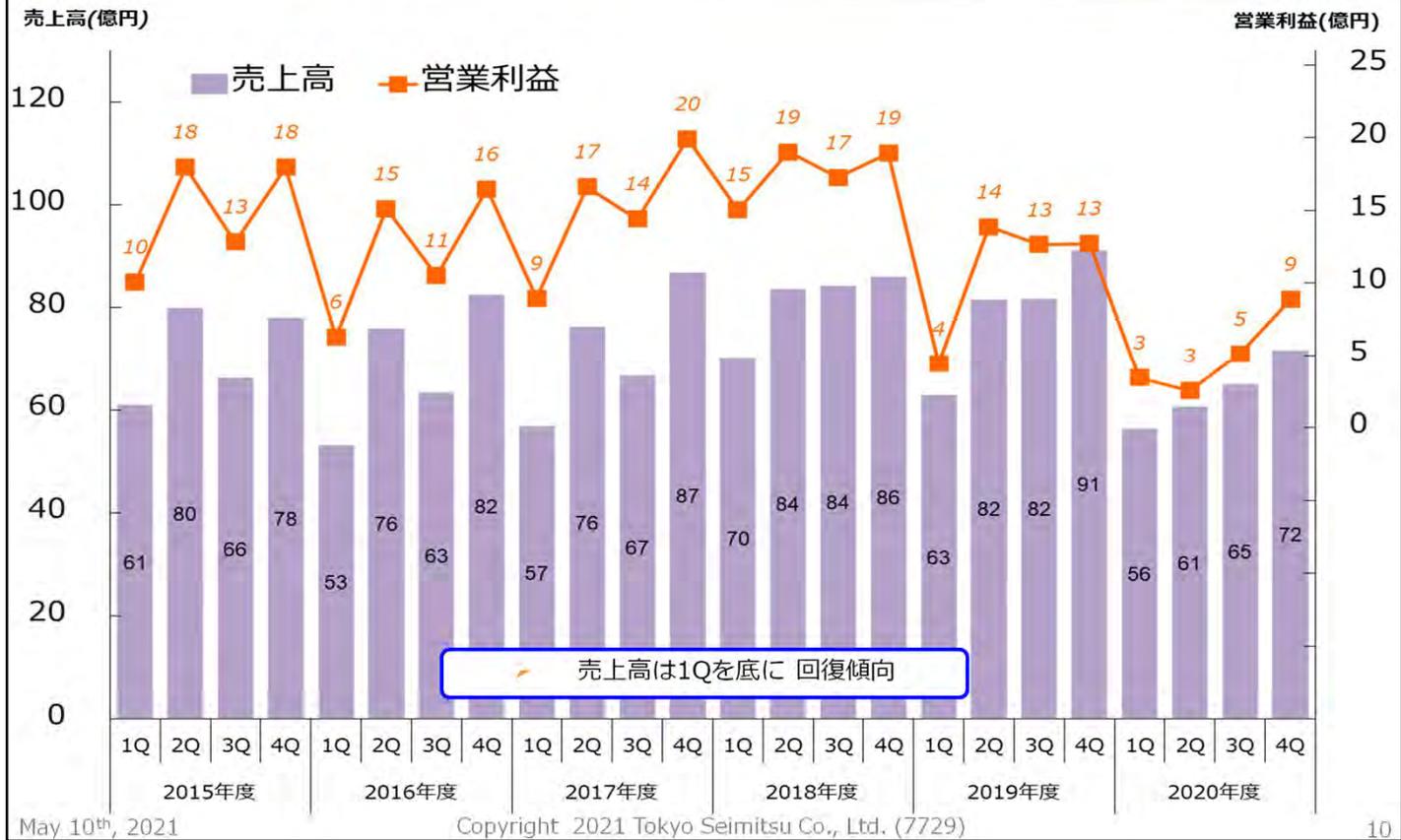
セグメント業績 (通期：億円)	2019年度		2020年度		
	通期		通期	予想対比	前年同期比
受注高	299		239		-20%
売上高	317		254	+18	-20%
営業利益 (営業利益率)	44 (14%)		20 (8%)		-54%

四半期業績(億円)	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	前四半期比	前年同期比
受注高	80	74	71	74	58	50	64	67	+4%	-9%
売上高	63	82	82	91	56	61	65	72	+10%	-21%
営業利益 (営業利益率)	4 (7%)	14 (17%)	13 (16%)	13 (14%)	3 (6%)	3 (4%)	5 (8%)	9 (12%)	+74%	-30%

- 売上高は公表予想対比上振れも 前期比 減収減益
- 年度を通じて新型コロナの影響を受けた
- 受注高は第2四半期を底に 緩やかに回復

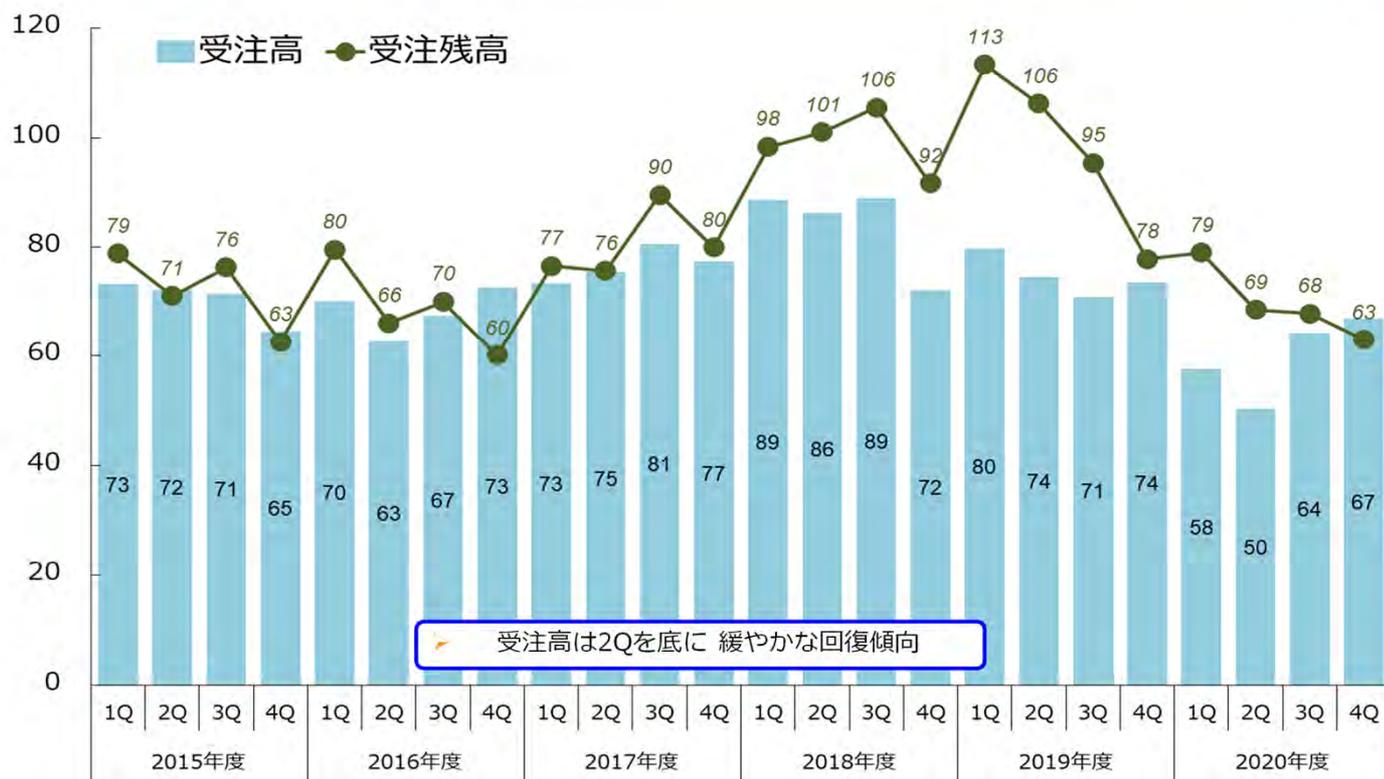
- 通期売上高は公表予想を上振れたものの、
年度を通じて新型コロナの影響を受け、減収減益の1年
- 受注高は2Qを底に緩やかな回復基調にあるほか、4Q利益率は10%台へ回復

計測 - 売上高, 営業利益



○ 売上高は1Qを底に継続して増加

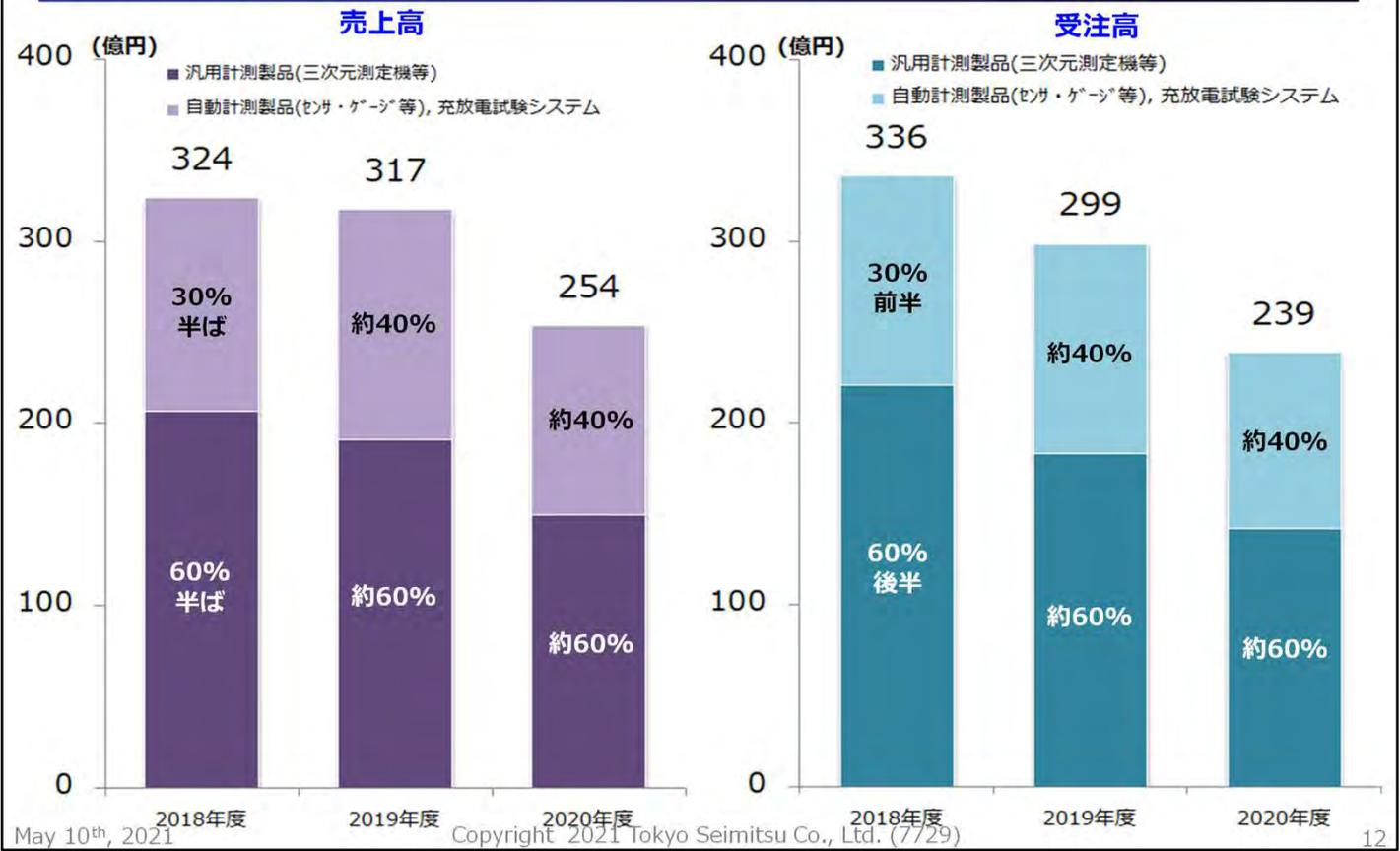
計測 - 受注高, 受注残高



受注高は2Qを底に 緩やかな回復傾向

- 4Q受注高は, 3Q比微増
- 2Qを底に緩やかな回復傾向が続いている

計測 - 製品別動向

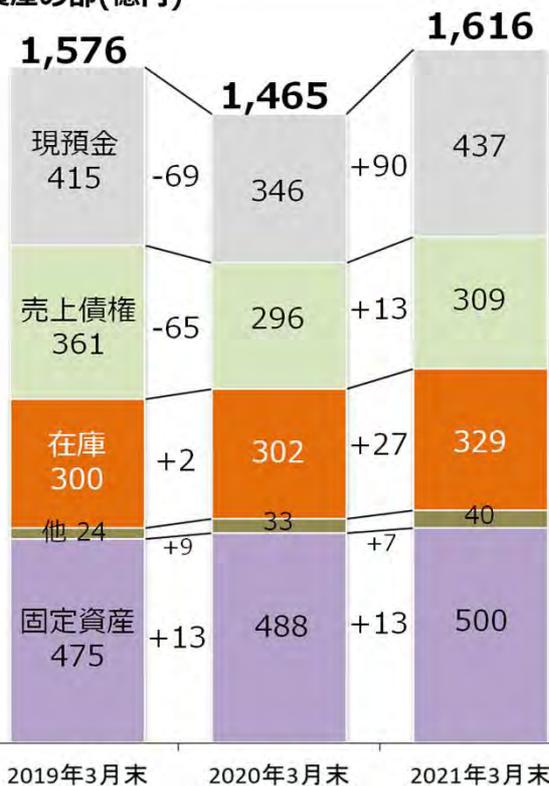


- 2020年度の製品別比率は、売上高(左側), 受注高(右側) ともに汎用計測 約6割, 自動計測・充放電システム約4割

貸借対照表



資産の部(億円)



負債・純資産の部(億円)



うち
有利子負債
76
(2020年3月末:
96)

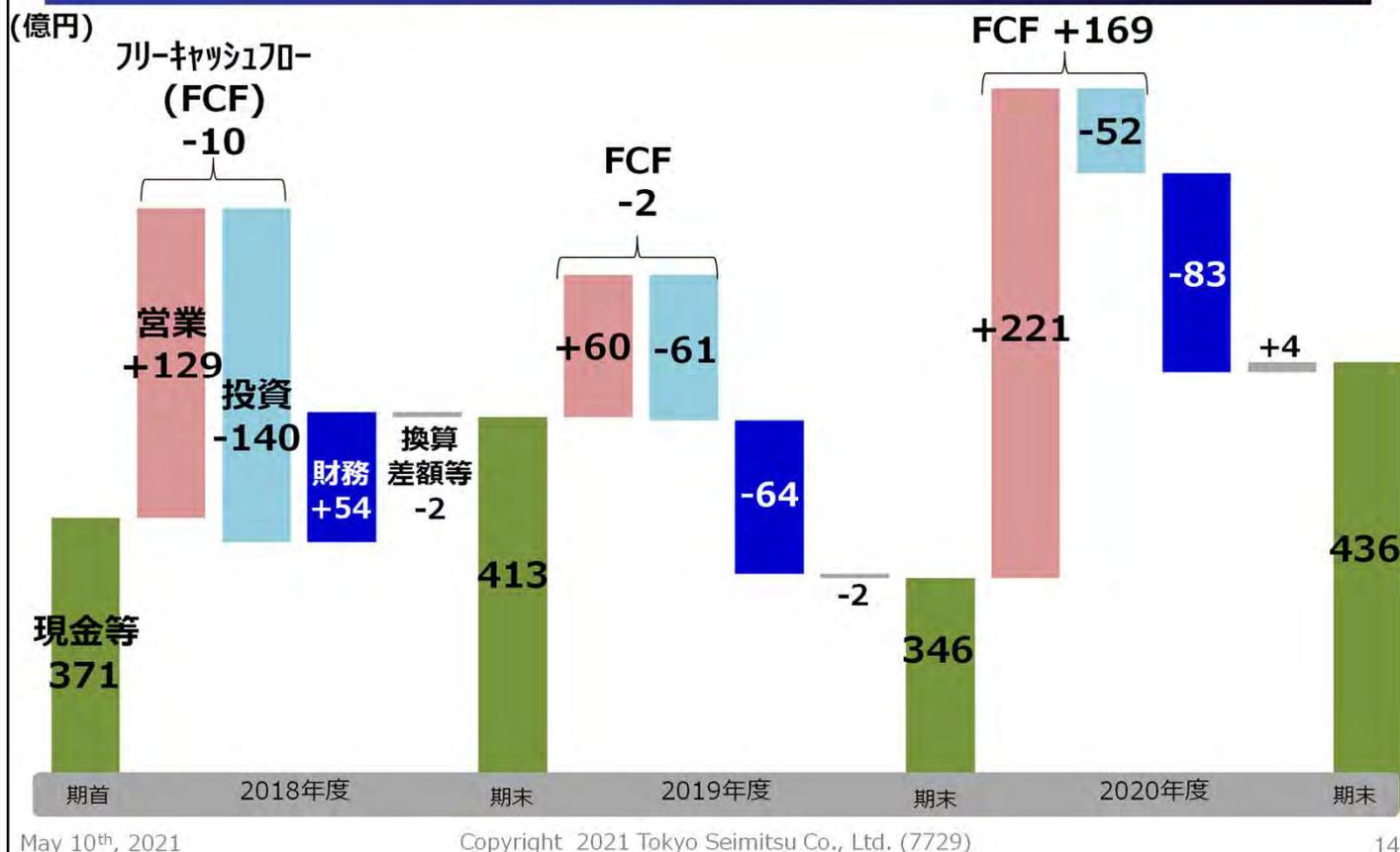
May 10th, 2021

Copyright 2021 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

13

- 2021年 3月末の総資産は1,616億円(前年3月末比 + 150億円)
- 自己資本比率は71.4%, 有利子負債残高は76億円

キャッシュフロー(CF)



- 2020年度キャッシュフロー(以下CF)
 営業CFは +221億円, 投資CF -52億円, 結果 フリーCFは+169億円
 財務CFは配当支払, 自己株式取得等により, -83億円
- この結果, 現金等の期末残高は436億円となった

子会社の不正行為：再発防止策と進捗



◆ 不正行為発覚による、特別調査委員会の調査/提言を受け、再発防止策取り組み中

会社	分野	施策(要約、TSE = 東精エンジニアリング)	対応中	完了
T S E	ガバナンス	取締役会の体制, 監査役監査の見直し等	○	
	内部統制	購買手続き, 販売に係る異例取引手続き, 海外子会社の社内規程の整備	○	
	コンプライアンス	統括責任者/統括管理者を設置(完了)、コンプライアンスの周知徹底 全役職員へのコンプライアンス研修の実施(国内実施中/海外準備中)	○	○
	モニタリング 体制	販売案件処理/運営点検の組織新設, 海外子会社モニタリング強化, 内部監査体制の強化および間接部門人員の拡充	○	
	社内環境、コミュ ニケーション	国内外全社員へ内部通報制度の趣旨/内容の再度周知徹底 社員の意見、声を吸い上げられる環境の整備	○	
当 社	ガバナンス	コミュニケーション強化を通じた各子会社の経営/事業課題の適時適切な解決 子会社の経営/事業課題が自発的/能動的に報告される環境づくり TSE社への取締役派遣(完了), 綿密に連携して取り組む体制を構築	○	○
	コンプライアンス	グループ全社員にコンプライアンス重視のトップ方針を経営陣から改めて発信		◎
	モニタリング 体制	統括責任者/統括管理者を設置(完了), コンプライアンスの周知徹底 全役職員へのコンプライアンス研修の実施(国内実施中/海外準備中)	○	○
	社内環境、コミュ ニケーション	各子会社がガバナンス, コンプライアンス, モニタリング 取り組みの確認/支援 TSEの内部監査/監査役監査内容を共有, 改善策フォロー, TSE内部監査	○	
		子会社と相互に情報共有を行って課題を解決する 双方向型のマネジメント方針を当社経営陣から発信		◎

May 10th, 2021

Copyright 2021 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

15

- 子会社 東精エンジニアリング(TSE)での 不正行為について、
3月15日に再発防止策を開示
- 骨子は、TSEのガバナンス体制等の整備に加え、
当社の子会社コミュニケーションの強化、
さらにグループ全体でコンプライアンス重視の方針を浸透させてゆくこと
- 進捗は定期的に皆様へ報告する所存

次第

- ◆ 2020年度 業績説明
- ◆ **中期目標 2020年度総括, 最終年度にあたって**
- ◆ 2021年度 業績予想
- ◆ 質疑応答

長期指標：ROE10%以上

中期目標：営業利益220億円

(2021年度迄) ←コロナ禍による市場前提の変化のため終了年度1年延期

両輪にて達成

売上拡大
(1,100億円を目指す)

利益率向上
(営業利益率20%以上を目指す)

- 当社は2018年5月に定量目標を開示
- 長期指標: ROE 10%以上維持
中期目標: 営業利益220億円達成(売上拡大と利益率向上の両輪で達成を目指す)
- 達成年度: 2020年度迄 → 2021年度迄 と 1カ年延長
新型コロナなど 前提とする事業環境の変化のため

技術面

製品競争力強化, 対象市場拡大

生産面

生産能力拡充, 効率改善(自動化, 省人化)

利益率改善

情報共有化促進
サービス, 消耗品売上の拡充

中期目標達成



持続的な成長のために

積極的にESG活動を推進し, 企業価値向上を図る

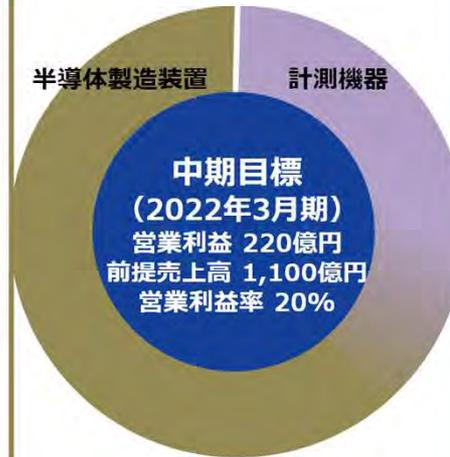
- 中期目標達成のための全社戦略は記載の通り
- 技術面: 既存製品の競争力を更に高め, 対象市場を更に拡大させる
- 生産面: 生産キャパシティの拡充と生産効率の改善を図る
- 利益率改善: 情報共有化の推進, 消耗品売上の拡充
- また持続的な成長のためのベースとして, ESG活動を積極的に推進

半導体製造装置

- 検査装置(プローバ)の“デパート化”戦略継続による 更なる市場拡大
- 加工装置のアプリケーション力強化・連動したサービスビジネス並びに消耗品売上の拡大
- 内製化促進, 新工場運用

計測機器

- 電気計測 (充放電試験) 進出による 対象市場拡大, シナジーの最大化
- 既存製品群の差異化・国内外顧客開拓と, 連動したサービスビジネスの拡大
- 生産効率化・自動化



May 10th, 2021

Copyright 2021 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

19

- 中期目標達成の為の事業セグメント別戦略は上記の通り
- 利益率は両セグメントとも20%を目指す
 売上高構成は 半導体 2/3, 計測 1/3としていたが
 現在は 半導体の構成が増加, 計測の減少を補完する形になっている

定量面



コロナ影響による計測の減収を半導体で補完

技術面



次世代技術にむけた製品の展開

生産面



キャパシティ拡張が進展
両事業の工場を有効活用

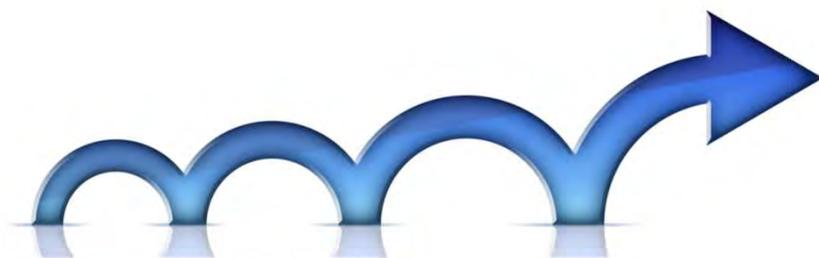
利益率
改善



半導体を中心に改善

- 中期目標 2020年度総括は記載の通り
- 定量面: 計測の減収を半導体で補完, 増収増益の着地
- 技術面: 電子部品プロセス革新に向けた研削装置, プローバ新モデル, 計測の特殊測定用製品などを展開
- 生産面: 半導体を中心にキャパ拡張, また計測の工場を有効活用
- 利益率: 半導体を中心に稼働率の上昇, 消耗品売上などで改善

- 2021年度は、前提となる売上高が 視野に入る
 - 半導体：短期的な調整に留意する必要があるが、極めて良好
 - 計測：緩やかな回復基調
- 達成のためのポイント：生産キャパシティの拡張



- 2021年度を、当中期目標の最終年度、計画通り進める予定
前提となる1,100億円の売上高が視野に入っているため
- 達成のためのポイントは、生産キャパシティの拡張
あらゆる施策をとり 目標を達成したい

キャパシティ拡充(半導体)

- 美山工場：フル稼働継続
- 新工場：日野工場に先駆け
飯能工場建設に着手



キャパシティ拡充 (計測：土浦MI棟)

- 2020年5月稼働開始
- 半導体装置生産にも活用



MI: *Monozukuri* Innovation

効率化

- ERPによる
業務改善・効率化
取り組み継続

アプリ対応強化 (台湾新アプリセンター設立)

- 2021年3月稼働開始



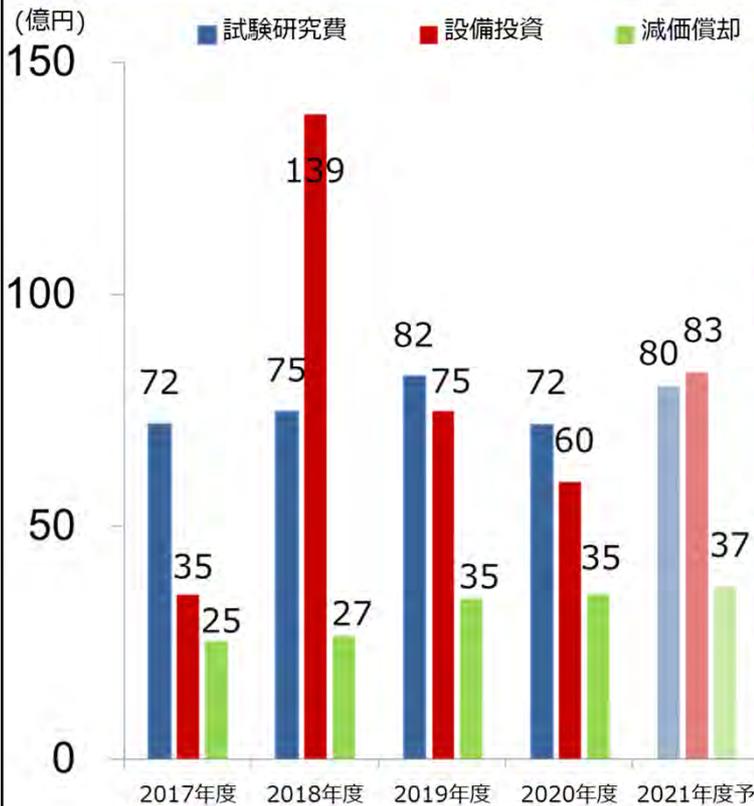
アプリ対応強化 (大阪計測センターリニューアル)

- 2020年1月稼働開始



- (左上) 日野工場(2022年度完工計画)着工が環境アセスメントの調査等で遅延
新たに埼玉県飯能市で、同期間中に工場建設するプロジェクトを新設・優先させる
- (右上) 2020年5月稼働開始した土浦MI棟は、半導体の生産にも活用
- (中段下) この程 台湾アプリケーションセンター 稼働開始

試験研究費, 設備投資, 減価償却



研究開発：製品力強化・競争力維持

➤ 売上高対比10%内を目安に強化

設備投資：能力増強・効率化等

➤ 半導体キャパシティ拡張(飯能・日野)で今後 数年間に200億円超の投資を計画
➤ 2020年度は計測MI棟, 台湾アプリケーションセンタ, 充放電向け設備投資が主体

減価償却

➤ 軽微な増加を見込む

May 10th, 2021

Copyright 2021 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

23

- 試験研究費は, 引き続き売上高の10%以内を目安
2020年度実績 72億円, 2021年度計画 80億円
- 設備投資は, 半導体のキャパシティ拡張に向けて 今後 数年間で 200億円超
2020年度実績 60億円, 2021年度計画 83億円
- 減価償却は, 2020年度実績 35億円, 2021年度計画 37億円

● 当社グループの主なステークホルダー



● 重要課題 (マテリアリティ)

環境	製品を通じての環境貢献 (エコプロダクツ)
	事業活動を通じての環境貢献 (エコファクトリー)
社会	製品を通じての価値提供
	持続可能なサプライチェーンの強化
	多様な人々が活躍できる職場づくり
ガバナンス	働きがいのある職場づくり
	経営基盤の強化
	コンプライアンスの強化

○ 当社のESG活動における重要課題(マテリアリティ)は記載の通り

○ 環境面 : エコプロダクツ, エコファクトリー

○ 社会面 : 製品を通じた価値の提供, サプライチェーン強化,
女性活躍を含めた 多様な人々が活躍でき, かつ働きがいのある職場づくり

○ ガバナンス : 経営基盤の強化, コンプライアンスの強化

重要課題(マテリアリティ)		2020年度活動実績	対応するSDGs
環境	製品を通じての環境貢献 (エコプロダクツ)	製品開発にLCAを配慮しCO ₂ 削減 制限物質の不使用徹底	 
	事業活動を通じての環境貢献 (エコファクトリー)	低炭素電力への切替(5kt/年削減) 土浦MI棟への太陽光パネル設置	 
社会	製品を通じての価値提供	世界中の最新技術/最終製品への貢献 品質, 安全性の高い製品展開	   
	持続可能なサプライチェーン の強化	サプライヤのCSR活動推進, 協力関係 の強化	
	多様な人々が活躍できる 職場づくり	女性活躍の促進	
	働きがいのある職場づくり	労働時間短縮, 有給休暇取得推進	
ガバナンス	経営基盤の強化	コロナ過で強固な財務体制を維持	
	コンプライアンスの強化	コンプライアンス規程の見直しと システム強化, 情報セキュリティ強化	

- 当社の 2020年度 ESG活動 総括は記載の通り
- 今後も各種活動を続け、持続可能な社会づくりに貢献していきたい

ヘルスケア



手術ロボット, 遠隔診療

暮らし



スマート家電, オンライン授業

モノづくり



スマートファクトリー

自動車



EV(電気自動車), 自動運転

金融



オンライン決済, 仮想通貨

仮想空間と現実空間の融合 (Society 5.0)



インフラストラクチャー



電子政府, イン트라ネットワーク

ロジスティクス



自動搬送倉庫, ドローン配達

エネルギー生成



エコロジーと効率を両立した発電

- 2022年度以降の中期目標の前提は,
ソサエティ5.0(仮想/現実空間の融合で あらゆる人とモノが結びつく)の世界
- 記載の技術 全てに半導体に関係し, 半導体市場の金額・数量成長は確実

- Society 5.0 (5Gを軸とする仮想空間・現実空間の融合)により, 半導体・電子部品の 桁違いの大量生産/大量消費の時代へ
- 微細化・大口径化の限界, 後工程SPEの重要性を更に高める
- 業績拡大の軸は, 引き続き 開発強化と生産キャパシティ拡張



- 半導体・電子部品は大量生産, 大量消費の時代に入る
- 前工程の技術革新の 制約により, 後工程装置の重要性が高まる
- 当社はこの前提のもと, 「位置決め」と「センシング」を活かした製品開発ならびにキャパシティの拡大を軸とした戦略やKPIを策定する方向

次期 中期目標の前提(計測)



- 内燃機関需要は減少してゆく
- 一方, NEV バッテリとモータの測定需要, 自動化(IoT)に大きな期待
- 業績拡大の軸は, 製品ラインナップ/参入分野の拡大と, 海外売上



May 10th, 2021

Copyright 2021 Tokyo Seimitsu Co., Ltd. (7729)

28

- 内燃機関の測定需要は減少すると予想
- その一方, EV バッテリー測定, パワートレインの より複雑で高精度な部品の測定需要は大きく拡大
- 加え, 半導体/航空機/医療 等 非自動車・成長業界での販路拡大, さらに, 半導体製造装置との組み合わせなど, 新たなソリューション拡大を狙う

次第

- ◆ 2020年度 業績説明
- ◆ 中期目標 2020年度総括, 最終年度にあたって
- ◆ **2021年度 業績予想**
- ◆ 質疑応答

全体

- 半導体は活況, 計測も緩やかな回復
- 年度通して高水準の生産が続く

半導体

- 受注は短期的な 調整を想定
前年下期比減少を見込むも, 高水準の需要が続く
- 生産拡張対応, 必要な研究開発を継続

計測

- モノづくり需要に緩やかな回復の兆し, 受注増加へ
- 半導体, NEV, 医療分野への拡販を推進

- 業績予想の前提は, “半導体は活況”, “計測は緩やかな回復”, “高水準の生産”
- 半導体における 短期的な受注調整はあり得るが, 水準は高いものと想定
- 計測では, モノづくり需要そのものが 回復
半導体, NEV, 医療など 多方面に展開し 業容の回復に努める

2021年度 業績予想



連結業績 (億円, 円)	2020年度			2021年度予			
	上期	下期	通期	上期予	下期予	通期予	前期比
売上高	451	520	971	590	590	1,180	+22%
営業利益 (営業利益率)	63 (14%)	93 (18%)	156 (16%)	108 (18%)	112 (19%)	220 (19%)	+41%
経常利益	64	95	159	108	112	220	+39%
当期純利益	47	75	122	75	77	152	+25%
1株配当			104円			130円	+26円

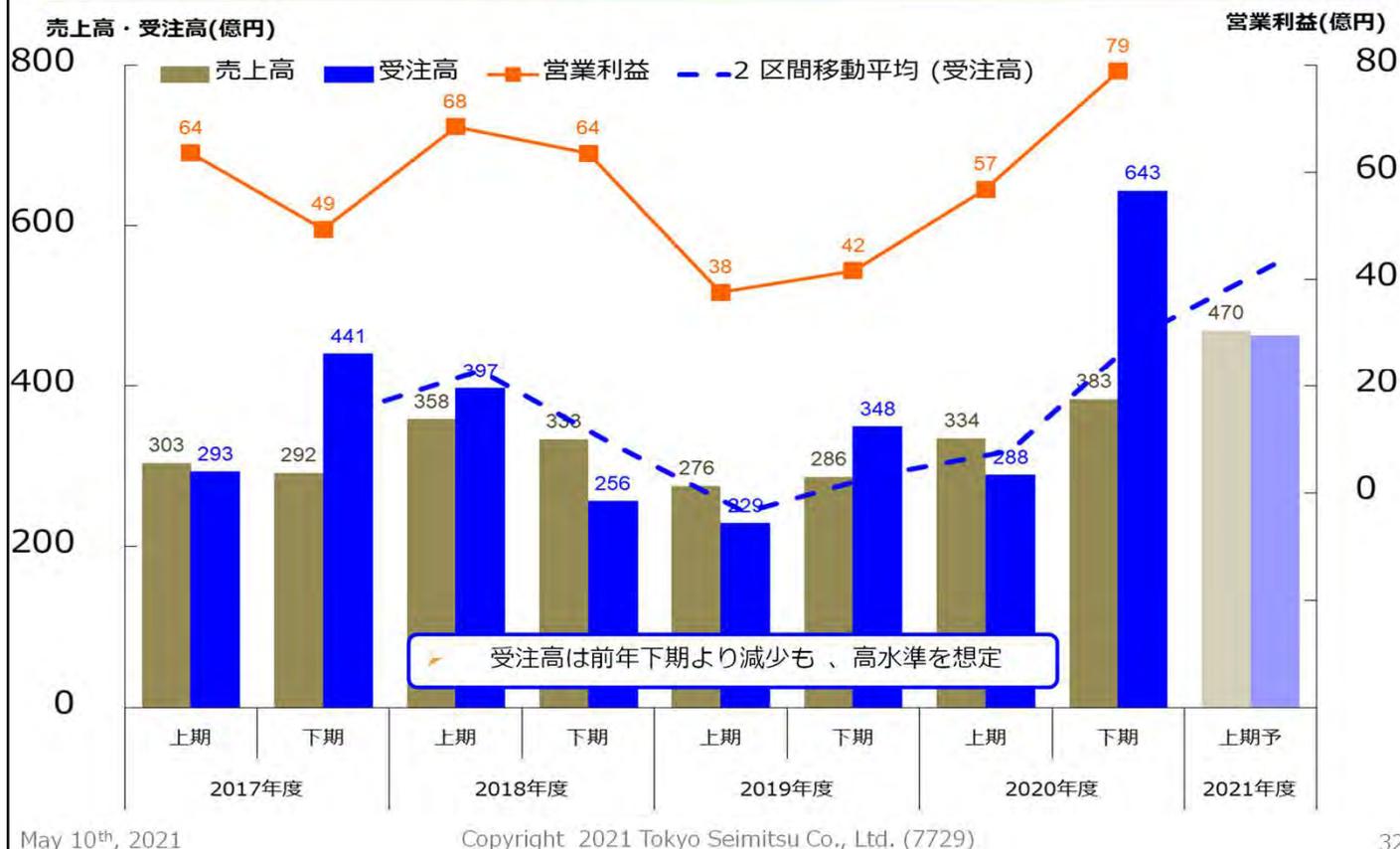
セグメント別業績予想

(半導体)	受注高	288	643	932				
	売上高	334	383	717	470	450	920	+28%
(計測)	受注高	108	131	239				
	売上高	117	137	254	120	140	260	+2%

- 半導体の好調を受け増収増益を予想
- 配当も増配を計画

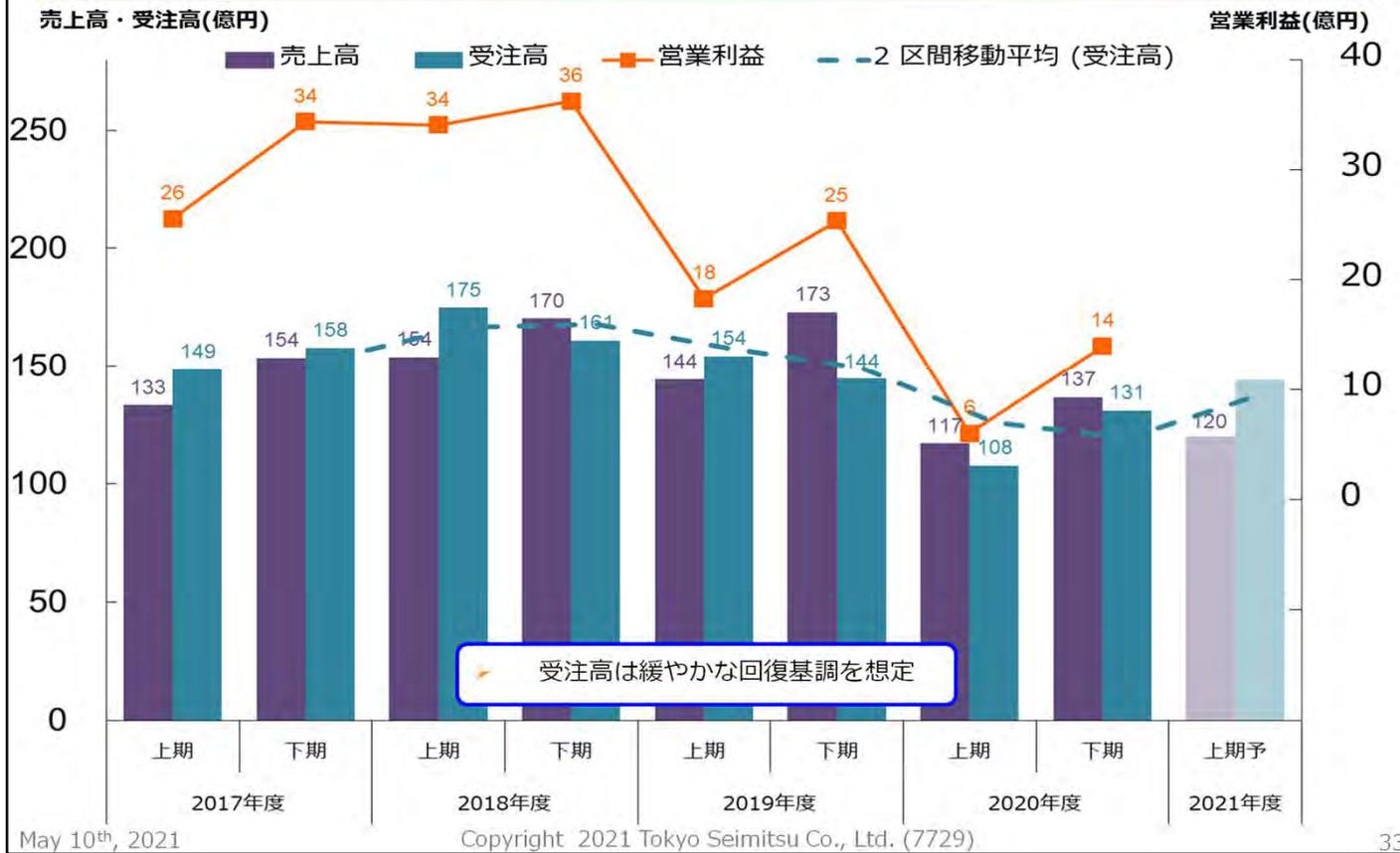
- 2021年度の業績予想は中期目標の達成を見込んでおり、売上高 1,180億円、営業利益220億円、経常利益220億円、当期純利益152億円
- セグメント別売上高予想：半導体 920億円、計測260億円 いずれも増収予想
- 2021年度年間配当は、1株130円(前期比 26円増)を予定

半導体 - 売上・受注高 見込



- 2021年度上期の受注は、2020年度下期のピークからは減少も高水準を想定
- 上期予想の製品構成比：
 売上高は 検査装置 6割，加工装置4割，
 受注高は 検査装置 5割後半，加工装置4割前半

計測 - 売上・受注高 見込



- 2021年度上期受注は、緩やかな回復基調を予想
- 上期予想の製品構成比： 売上高、受注高ともに
汎用計測 6割半ば、自動計測・充放電 3割半ば

次第

- ◆ 2020年度 業績説明
- ◆ 中期目標 2020年度総括, 最終年度にあたって
- ◆ 2021年度 業績予想
- ◆ 質疑応答



<https://www.accretech.jp/>
<https://ir.accretech.jp/ja/index.html>



補足資料

セグメント別業績推移



(百万円)	会計期間				四半期								
	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2020年3月期				2021年3月期				
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	
受注高	半導体	73,327	65,335	57,709	93,181	10,694	12,177	15,375	19,462	12,903	15,932	28,683	35,662
	計測	30,651	33,573	29,866	23,878	7,974	7,446	7,086	7,359	5,754	5,022	6,420	6,681
	合計	103,979	98,909	87,576	117,060	18,668	19,624	22,461	26,821	18,657	20,955	35,103	42,344
受注残高	半導体	31,452	27,670	29,182	50,619	26,689	22,991	24,303	29,182	26,653	24,610	38,188	50,619
	計測	7,996	9,165	7,782	6,301	11,333	10,623	9,538	7,782	7,898	6,855	6,783	6,301
	合計	39,448	36,836	36,965	56,920	38,022	33,615	33,842	36,965	34,552	31,465	44,971	56,920
売上高	半導体	59,523	69,117	56,198	71,745	11,676	15,874	14,063	14,583	15,432	17,975	15,106	23,231
	計測	28,671	32,403	31,728	25,359	6,285	8,157	8,170	9,115	5,638	6,066	6,491	7,163
	合計	88,194	101,520	87,927	97,105	17,962	24,031	22,233	23,698	21,070	24,041	21,597	30,395
営業利益	半導体	11,292	13,195	7,915	13,565	1,358	2,399	2,111	2,046	2,832	2,850	2,525	5,358
	計測	5,990	7,025	4,366	1,996	443	1,387	1,265	1,270	344	255	510	886
	合計	17,283	20,221	12,282	15,562	1,802	3,786	3,376	3,317	3,176	3,105	3,035	6,245
営業利益率	半導体	19.0%	19.1%	14.1%	18.9%	11.6%	15.1%	15.0%	14.0%	18.4%	15.9%	16.7%	23.1%
	計測	20.9%	21.7%	13.8%	7.9%	7.1%	17.0%	15.5%	13.9%	6.1%	4.2%	7.9%	12.4%
	合計	19.6%	19.9%	14.0%	16.0%	10.0%	15.8%	15.2%	14.0%	15.1%	12.9%	14.1%	20.5%

損益計算書



(百万円)	会計期間				四半期							
	2018年 3月期	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2020年3月期				2021年3月期			
					1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q
売上高	88,194	101,520	87,927	97,105	17,962	24,031	22,233	23,698	21,070	24,041	21,597	30,395
売上原価	53,818	60,430	53,452	60,190	10,862	14,687	13,357	14,544	12,863	15,433	13,504	18,389
売上総利益	34,375	41,090	34,474	36,914	7,100	9,344	8,876	9,154	8,207	8,608	8,093	12,005
販売費および一般管理費	17,092	20,869	22,192	21,351	5,297	5,557	5,499	5,837	5,030	5,502	5,057	5,760
営業利益	17,283	20,221	12,282	15,562	1,802	3,786	3,376	3,317	3,176	3,105	3,035	6,245
営業外収益	170	688	255	540	131	78	102	-57	194	118	106	214
営業外費用	138	104	177	235	38	18	51	68	25	153	205	-55
経常利益	17,316	20,805	12,360	15,867	1,895	3,846	3,426	3,191	3,345	3,070	2,936	6,515
特別利益	4	58	57	1,354	2	10	43	1	6	-	149	1,198
特別損失	2	419	1,712	1,074	-	-	42	1,669	-	293	108	672
税引前利益	17,318	20,443	10,705	16,147	1,897	3,856	3,427	1,523	3,351	2,776	2,977	7,041
法人税等合計	4,542	5,719	3,598	3,978	505	1,009	1,153	930	886	573	712	1,806
親会社株主に帰属する 当期純利益	12,717	14,665	7,156	12,175	1,402	2,859	2,281	613	2,470	2,207	2,264	5,232
1株当たり当期純利益(円)	306.41	352.92	171.89	293.83	33.70	68.69	54.80	14.73	59.30	52.98	54.73	127.55
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益(円)	304.02	350.23	170.72	291.43	-	-	-	-	-	-	-	-

貸借対照表



(百万円)		2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
流動資産	現金及び預金	37,220	41,518	34,640	43,657
	売上債権※1	33,439	36,146	29,633	30,946
	在庫	22,325	29,995	30,152	32,886
	その他	3,364	2,434	3,345	4,025
	合計	96,349	110,094	97,771	111,516
固定資産合計		36,645	47,478	48,777	50,039
総資産		132,995	157,573	146,549	161,556
流動負債	買入債務※2	21,870	26,328	16,895	23,062
	その他	10,936	14,620	12,121	16,233
	合計	32,807	40,948	29,017	39,296
固定負債合計		833	9,220	7,857	5,482
負債合計		33,640	50,169	36,874	44,778
純資産合計		99,354	107,403	109,674	116,777
負債・純資産合計		132,995	157,573	146,549	161,556
有利子負債合計		1,351	11,415	9,641	7,581
自己資本比率		74.0%	67.3%	73.9%	71.4%
自己資本利益率(ROE)		13.8%	14.4%	6.7%	10.9%

※1: 電子記録債権を含む ※2: 電子記録債務を含む

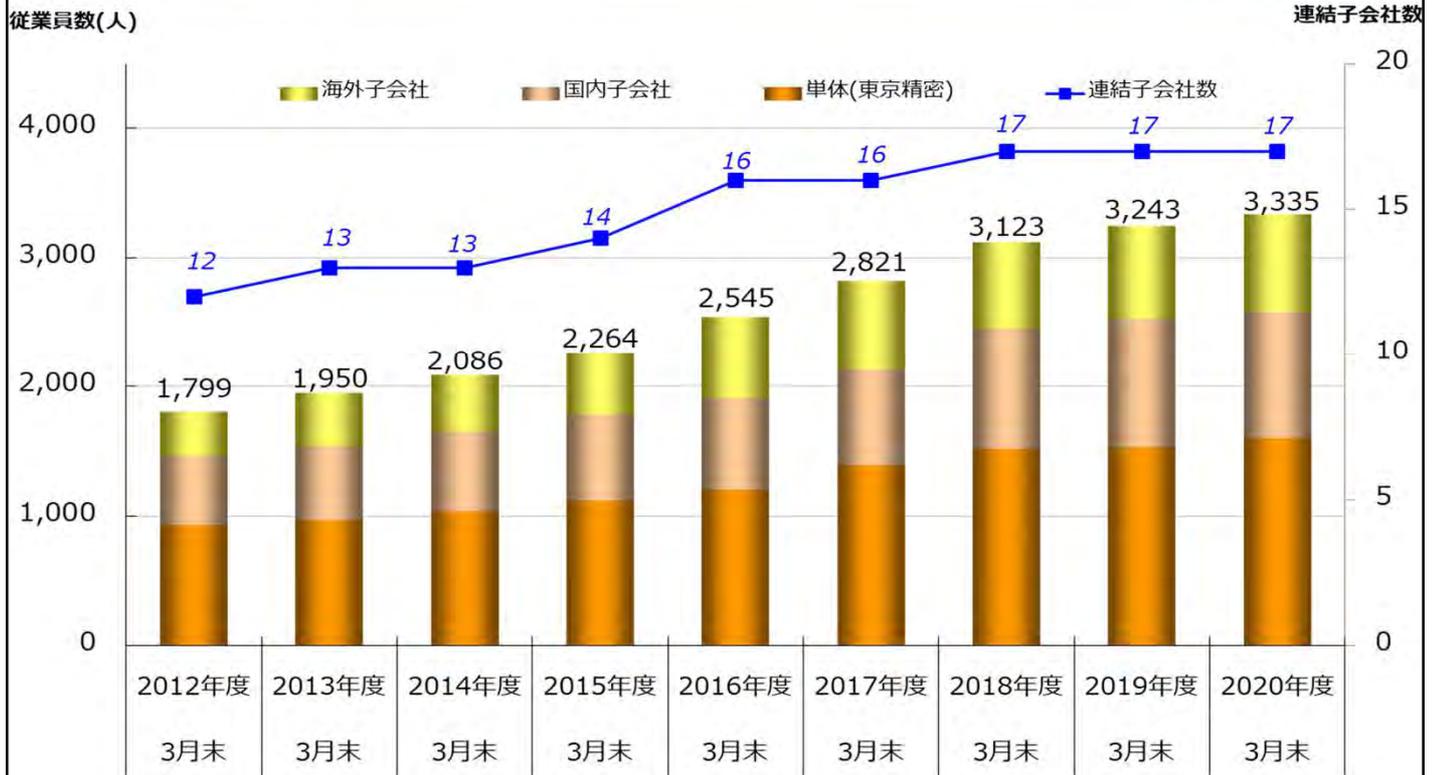
各種費用, キャッシュフロー



(百万円)	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
試験研究費	7,194	7,469	8,234	7,193
設備投資	3,547	13,872	7,477	5,950
減価償却費(のれん除く)	2,541	2,655	3,450	3,516

(百万円)	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期	2021年3月期
営業活動によるキャッシュフロー	10,931	12,932	5,965	22,062
投資活動によるキャッシュフロー	-4,649	-13,952	-6,116	-5,191
フリーキャッシュフロー	6,281	-1,020	-150	16,871
財務活動によるキャッシュフロー	-3,163	5,443	-6,375	-8,282
現金及び現金同等物に係る 換算差額等	147	-223	-159	429
現金及び現金同等物の期末残高	37,090	41,290	34,605	43,624

従業員数推移



注) 上記従業員は、正社員と期末時点の臨時従業員の単純合算